

精材科技股份有限公司
民國一〇五年股東常會議事錄

時 間： 中華民國一〇五年六月十四日上午九時

地 點： 桃園市中壢區中園路188號

本公司已發行總股數：269,194,781股

出席股東(含電子投票)及代理人所持股數：141,222,272股

出席股數占全部已發行股數：52.46%

出席董事：關欣、謝徽榮

主 席：關欣董事長

記 錄：林恕敏

議 程：

壹、大會報告出席股數已達法定數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞（略）

參、討論事項

一、案由：核准修訂本公司「公司章程」。(董事會提)

說明：(一) 依公司法修訂及公司實務作業之需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 141,020,133 權，贊成權數 125,929,443 權，占總權數 89.30%；反對或棄權權數 15,090,690 權，占總權數 10.70%。本案照原案表決通過。

肆、報告事項

一、員工及董事酬勞報告，報請公鑒。

說明：本公司提撥 104 年度員工現金酬勞 8.3%，計新台幣 19,675,275 元及董事現金酬勞 1.0%，計新台幣 2,289,785 元（已扣除獨立董事報酬新台幣 1,800,000 元），業經 105 年 2 月 3 日董事會決議通過，並將於股東會通過章程修訂案後給付之。

二、民國一〇三年度營業報告（詳附件一）。

三、審計委員會報告（詳附件二）。

伍、承認及討論事項

一、案由：承認一〇四年度之營業報告書及財務報表。（董事會提）

說明：（一）本公司民國一〇四年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林政治會計師查核完竣。

（二）民國一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件二及附件四。

（三）敬請 承認。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 141,105,272 權，贊成權數 125,932,443 權，占總權數 89.25%；反對或棄權權數 15,172,829 權，占總權數 10.75%。本案照原案表決通過。

二、案由：核准一〇四年度盈餘分派之議案。（董事會提）

說明：（一）本次盈餘分派案，係分配 104 年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣 0.5 元，現金配發計算至元為止（元以下捨去），配發不足 1 元之畸零款，列入本公司之其他收入。本公司盈餘分配原則，係先分配 104 年度盈餘，不足部份則依盈餘產生之年序，採後進先出法之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘。

（二）本案經股東常會通過後，由董事長訂定除息基準日。嗣後如因本公司員工認股權之行使，而須發行新股，或因其他交易事項致影響本公司流通在外股份總數時，請授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額新台幣 134,438,065 元，按除息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。

（三）民國一〇四年度盈餘分派表，請參閱附件五。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 141,105,272 權，贊成權數 125,933,443 權，占總權數 89.25%；反對或棄權權數 15,171,829 權，占總權數 10.75%。本案照原案表決通過。

三、案由：核准發行限制員工權利新股。(董事會提)

說明：本公司擬發行限制員工權利新股 1,500,000 股案，相關說明如下：

(一) 發行總額：普通股 1,500,000 股，每股面額新台幣 10 元，共計新台幣 15,000,000 元。

(二) 發行條件：

1. 發行價格：無償發行(每股新台幣0元)

2. 既得條件(同時符合公司績效及個人績效，下述既得之股份以無條件捨去計算並以股為單位)：

(1) 第一年既得日(發行日起算期滿一年)：

公司績效EPS(註1)為正數且較前一年度成長10%(含)以上；且個人績效於第一年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績S(含)以上者，得分批既得20%股份。

(2) 第二年既得日(發行日起算期滿兩年)：

公司績效EPS為正數且較前一年成長10%(含)以上；且個人績效於第二年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績S(含)以上者，得分批既得20%股份。

(3) 第三年既得日(發行日起算期滿三年)：

a. 公司績效EPS為正數且較前一年成長10%(含)以上；且個人績效於第三年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績S(含)以上者，得分批既得26.7%股份。

b. 公司績效EPS大於新台幣2元(含)以上；且個人績效於第三年既得日仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約且當年度考績S(含)以上者，得再分批既得33.3%股份。

附註：1. 公司績效EPS：係指既得日當年之前一年度經會計師查核簽證之合併財務報表揭露之基本每股盈餘。

2. 本公司對個人績效評等以O(Outstanding)、S(Successful)、I(Improvement Needed)、U(Unacceptable)四個績效評等為原則。

3. 未達既得條件之處理方式：當年度尚未既得之股份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

4. 員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：

(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、

請求公司買回，或作其他方式之處分。

(2)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。

(3)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權益(包括但不限於現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積現金(股票))。

(三)員工之資格條件及得獲配股數：

1. 以本公司正式編制內之全職員工為限。授予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，並考量公司經營績效、營運需求及業務發展策略所需，授權董事長核訂，提報董事會同意，惟具經理人身分、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
2. 本公司給予單一員工得獲配之限制員工權利新股股數與限額依「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定辦理。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司發展所需之專業人才，激勵員工長期績效，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

若全數達成既得條件，暫以 105 年 4 月 25 日(董事會召集通知寄發之前一日)收盤價每股 27.25 元計算，可能費用化總金額約為新台幣 40,875 仟元。預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為 0.56%，對公司未來每股盈餘可能減少金額約為新台幣 0.15 元，其稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。

(六)發行辦法報經主管機關核准後生效，若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂發行辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 141,105,272 權，贊成權數 125,908,382 權，占總權數 89.23%；反對或棄權權數 15,196,890 權，占總權數 10.77%。本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

案由：董事改選案。(董事會提)

說明：(一) 因本公司現任董事任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會中改選五席董事(含獨立董事三席)。新選任之董事任期為三年，任期自105年6月14日起至108年6月13日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(二) 依公司章程第15條規定，本公司董事之選舉，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事會業於105年5月4日完成董事(含獨立董事)候選人資格審查，董事(含獨立董事)候選人名單請參閱附件六。

(三) 敬請 選舉。

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單及當選權數如下：

股東戶號 或身份證號	職稱	姓 名	當選權數
1532	董事	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：關欣	127,668,344
1532	董事	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：林錦坤	125,299,686
A103389XXX	獨立董事	王文宇	122,359,951
A103953XXX	獨立董事	謝徽榮	122,327,601
J220092XXX	獨立董事	溫瓊岸	122,289,778

柒、討論事項

案由：核准解除新任董事之競業禁止限制。(董事會提)

說明：(一) 依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二) 爰依法提請股東常會同意本次新任董事於上述情事時，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制內容，請參閱附件七。

(四) 提請 討論。

決議：本案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 141,105,272 權，贊成權數 124,368,424 權，占總權數 88.14%；反對或棄權權數 16,736,848

權，占總權數 11.86%。本案照原案表決通過。

捌、臨時動議

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。



主 席：關 欣



記 錄：林 恕 敏

精材科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂原因
第三條	本公司設總公司於桃園縣，必要時得經過董事會決議： 一、於國內外各地設立分公司或工廠。 二、得因業務需要對外擔任保證人。 三、本公司如為其他公司有限責任股東時，其所投資總額佔實收股本的比例不受公司法第十三條百分之四十的限制。	本公司設總公司於桃園 <u>縣市</u> ，必要時得經過董事會決議： 一、於國內外各地設立分公司或工廠。 二、得因業務需要對外擔任保證人。 三、本公司如為其他公司有限責任股東時，其所投資總額佔實收股本的比例不受公司法第十三條百分之四十的限制。	依實際需要修訂。
第廿七條	本公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。每年度決算如有盈餘，應先完納稅捐，彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限，次依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額依序作下列之分配： 一、提撥不低於百分之一為員工紅利。 二、提撥不高於百分之二為董事酬勞，且給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事。 三、餘額由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。 四、前項有關員工紅利部份，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。	<u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事，員工酬勞及董事酬勞應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依規定比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</u> 本公司 無盈餘時，不得分派股息及紅利。 每年度決算如有盈餘，應先 <u>依法</u> 完納稅捐，彌補 <u>累積以往年度虧損後</u> ，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時， <u>得不提列不在此限，其餘再次</u> 依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後； <u>如尚有，再就其餘額，併同累積未分配盈餘，依序作下列之分配：</u> 一、提撥不低於百分之一為員工紅利。 二、提撥不高於百分之二為董事酬勞，且給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事。 三、餘額由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。	依法令規定及實際需要修訂。

條次	現行條文	修訂後條文	修訂原因
		本條第一四前項有關員工酬勞紅利部份，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。 <u>本條第一項之「獲利」係指稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益。</u>	
第卅條	本章程訂立於中華民國八十七年六月十六日。 第一次修正於中華民國八十九年七月二十五日。 第二次修正於中華民國九十年七月二十四日。 第三次修正於中華民國九十一年六月二十八日。 第四次修正於中華民國九十二年一月十日。 第五次修正於中華民國九十二年六月二十七日。 第六次修正於中華民國九十三年六月二十八日。 第七次修正於中華民國九十四年六月二十九日。 第八次修正於中華民國九十五年六月十六日。 第九次修正於中華民國九十五年十二月五日。 第十次修正於中華民國九十六年三月五日。 第十一次修正於中華民國九十六年六月七日。 第十二次修正於中華民國九十八年六月四日。 第十三次修正於中華民國一百零六年六月十六日。 第十四次修正於中華民國一百零一年六月十四日。 第十五次修正於中華民國一百零二年六月十三日。 第十六次修正於中華民國一百零四年六月十六日。	本章程訂立於中華民國八十七年六月十六日。 第一次修正於中華民國八十九年七月二十五日。 第二次修正於中華民國九十年七月二十四日。 第三次修正於中華民國九十一年六月二十八日。 第四次修正於中華民國九十二年一月十日。 第五次修正於中華民國九十二年六月二十七日。 第六次修正於中華民國九十三年六月二十八日。 第七次修正於中華民國九十四年六月二十九日。 第八次修正於中華民國九十五年六月十六日。 第九次修正於中華民國九十五年十二月五日。 第十次修正於中華民國九十六年三月五日。 第十一次修正於中華民國九十六年六月七日。 第十二次修正於中華民國九十八年六月四日。 第十三次修正於中華民國一百零六年六月十六日。 第十四次修正於中華民國一百零一年六月十四日。 第十五次修正於中華民國一百零二年六月十三日。 第十六次修正於中華民國一百零四年六月十六日。 <u>第十七次修正於中華民國一百零五年六月十四日。</u>	增列修訂日期及次數

精材科技股份有限公司
民國一〇四年度營業報告書

有鑑於行動裝置對於影像感測器之市場需求在包括筆電、平板、手機、汽車、監控等領域持續增加，促使影像感測器晶圓製程持續往十二吋高階製程邁進，以因應此市場需求，精材公司已於民國一〇四年順利完成十二吋 3D 晶圓級尺寸封裝（300mm 3D Wafer Level Chip Scale Package）產線之建置，並已順利進入量產階段，預估此項投資於後續導入客戶十二吋影像感測器產品後，將逐漸展現建置之效益。同時，此項投資與技術，未來亦將應用於其他感測器領域，為本公司開啟新契機。

車用感測器方面，精材公司目前是世界最大而且唯一能提供符合車用規格的晶圓級尺寸封裝供應者。由於行車安全日漸講究，車規封裝的需求及產量成長非常迅速。車規封裝技術特殊、產品壽命長、營收穩定，將逐漸成為精材公司穩健成長之基石。

除影像感測器外，新式光感測器、加速度計、陀螺儀等微機電（MEMS）感測器已成為行動及穿戴裝置的標準配備。精材公司在此領域耕耘多年，其結果已展現於營收績效。此外，因應隱私保護及金融交易需求衍生之生物辨識感測器產品，於民國一〇四年持續為既有客戶提供服務外，目前已成功開發數款 3D 晶圓級尺寸封裝解決方案，陸續提供客戶產品認證，以確保精材公司生物辨識感測器產品封裝之領先地位，並為未來奠定穩健的成長動能。

經營實績

精材公司民國一〇四年全年營收為新台幣 4,878,088 仟元，較前一年營收 4,934,078 仟元減少 1%；稅後淨利為新台幣 146,799 仟元，較前一年稅後淨利 628,653 仟元減少 77%，每股淨利為新台幣 0.56 元。

企業發展

永續發展與成長是對股東及社會的承諾。精材公司除了與 IC 設計、晶圓製造公司及終端客戶合作開發創新晶圓級封裝技術外，更積極讓原有技術發揚光大，應用於不同產品，使其有超越摩爾定律（More than Moore）之功。影像感測器之晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層（Post Passivation Interconnect）技術擴展其應用至汽車電子及監控裝置；矽穿孔（Through Silicon Via，簡稱 TSV）技術應用至微機電系統等均為非常成功的例子。而物聯網（Internet of Things，IoT）的急速發展，對小尺寸、智慧型感測器（Integrated Smart Sensor）的需求愈來愈殷切。精材公司積極發展之先進整合式三維晶圓級尺寸封裝解決方案將成為客戶切入物聯網市場的關鍵技術，亦為精材公司企業永續發展之核心策略。

技術與創新

先進技術的研發與製造技術的精進不只提升企業競爭優勢；嶄新技術亦能為客戶及市場帶來突破，製造技術精進能提升良率，此兩者是精材公司對客戶及市場的承諾。民國一〇四年，除了順利將 3D 晶圓級尺寸封裝技術成功導入加速度感應器外，也將此技術擴散至生物辨識晶片、環境感測等產品；而厚銅技術在整合被動元件量產的成功激發精材公司繼續整合矽穿孔技術的想法；精材公司把兩種技術混合應用於射頻（RF）元件亦成功導入量產。

民國一〇五年，精材公司除了擴展十二吋晶圓級封裝技術到新應用領域，如微機電、生物識別等產品外，亦將聚焦於先進晶圓級封裝技術之整合，包括結合矽穿孔與後護層技術、開發先進晶圓級三維堆疊封裝技術(Advanced 3D Wafer Based Stacking Technology)、針對異質元件產品整合提供 SiP 封裝解決方案，滿足物聯網市場對於高整合、小型化智慧型元件(Smart Device)的強勁需求；客戶的產品將可藉由本技術，降低其終端客戶產品設計複雜度並簡化產品製造流程與成本，協助其終端客戶取得進入物聯網市場之先機。

前景與展望

展望民國一〇五年，物聯網市場觸發的三項爆發性成長產業均與精材公司有莫大的關係。在智慧汽車 (Smart Car) 方面，不管是車內、外監控或自動駕駛 (Autonomous Driving) 都需藉由大量影像感測器以實現上述願景，身為全球唯一的車用影像感測器晶圓級尺寸封裝提供者，角色之重要性不言可喻。在智慧家庭 (Smart Home) 與智慧城市等領域裡，精材公司三維晶圓級封裝解決方案，將成為客戶進入影像感測器元件、生物識別晶片及環境感測器等關鍵感測器的利器。為因應無人空拍機 (Drone) 的爆發性成長，精材公司發展之輕、薄、微型封裝契合其系統需求，將可應用於包括影像感測器、加速感應器、陀螺儀等多重感應器與無線連結元件，預期晶圓級尺寸封裝技術將在無人空拍機領域引領風潮。未來，精材公司除了加速研發以提供市場需要的技術外，更會積極的把現有技術應用至更多的領域，超越摩爾定律成為先進晶圓級封裝服務之領導者。

董事長：關欣



經理人：關欣



會計主管：林恕敏



附件三

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四、第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

精材科技股份有限公司

審計委員會召集人： 謝徽榮



中 華 民 國 一 〇 五 年 二 月 三 日

附件四

會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

精材科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

精材科技股份有限公司民國 104 年度財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

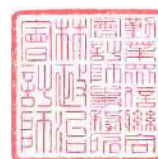
會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



會計師 林 政 治

林政治



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 105 年 2 月 3 日

精材科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 104 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 824,386	10	\$ 806,445	9	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	\$ 5,423	-	\$ 12,644	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	-	-	389	-	2125	避險之衍生金融負債（附註八）	1,774	-	823	-
1170	應收帳款淨額（附註九）	344,108	4	265,766	3	2170	應付帳款（附註三一）	277,606	3	287,046	3
1180	應收關係人款項（附註九及三一）	240,676	3	673,319	8	2201	應付薪資及獎金	159,670	2	199,664	2
1210	其他應收關係人款項（附註三一）	27,720	-	-	-	2206	應付員工酬勞／紅利及董事酬勞（附註十九及二八）	21,965	-	87,187	1
1310	存貨（附註五及十）	239,935	3	213,777	2	2213	應付工程及設備款	424,941	5	460,129	5
1476	其他金融資產	672	-	2,697	-	2230	本期所得稅負債（附註二六）	1,866	-	83,678	1
1479	其他流動資產（附註十四及三一）	93,964	1	72,858	1	2250	負債準備（附註五及十五）	83,115	1	60,155	1
11XX	流動資產合計	1,771,461	21	2,035,251	23	2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十七及三二）	336,000	4	275,000	3
	非流動資產					2399	應付費用及其他流動負債（附註三一）	280,532	4	294,124	4
1543	以成本衡量之金融資產（附註十一）	-	-	-	-	21XX	流動負債合計	1,592,892	19	1,760,450	20
1600	不動產、廠房及設備（附註五、十二及三二）	6,561,638	77	6,591,778	75		非流動負債				
1780	無形資產（附註十三）	81,986	1	87,437	1	2541	長期銀行借款（附註十七及三二）	1,049,000	12	2,387,500	27
1840	遞延所得稅資產（附註五及二六）	94,857	1	102,010	1	2550	負債準備（附註五及附註十五）	25,076	-	25,076	-
1920	存出保證金	9,271	-	8,904	-	2640	淨確定福利負債（附註十八）	364	-	-	-
1975	淨確定福利資產（附註十八）	-	-	1,889	-	25XX	非流動負債合計	1,074,440	12	2,412,576	27
15XX	非流動資產合計	6,747,752	79	6,792,018	77	2XXX	負債合計	2,667,332	31	4,173,026	47
							權 益（附註十九及二八）				
							股本				
						3110	普通股股本	2,688,761	32	2,381,207	27
						3200	資本公積	1,580,613	18	547,724	6
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	259,553	3	196,688	2
						3320	特別盈餘公積	823	-	281	-
						3350	未分配盈餘	1,323,905	16	1,529,166	18
						3300	保留盈餘合計	1,584,281	19	1,726,135	20
						3400	其他權益	(1,774)	-	(823)	-
						3XXX	權益合計	5,851,881	69	4,654,243	53
1XXX	資 產 總 計	\$ 8,519,213	100	\$ 8,827,269	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 8,519,213	100	\$ 8,827,269	100

後附之附註係本財務報表之一部份。

董事長：關欣

經理人：關欣

會計主管：林恕敏

精材科技股份有限公司

綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、二一及三一）	\$ 4,878,088	100	\$ 4,934,078	100
5000	營業成本（附註十、二八及三一）	<u>4,186,717</u>	<u>86</u>	<u>3,985,874</u>	<u>81</u>
5950	營業毛利	<u>691,371</u>	<u>14</u>	<u>948,204</u>	<u>19</u>
	營業費用（附註二八及三一）				
6100	行銷費用	43,315	1	39,809	1
6200	管理費用	109,767	2	147,006	3
6300	研究發展費用	<u>359,845</u>	<u>7</u>	<u>276,680</u>	<u>5</u>
6000	合 計	<u>512,927</u>	<u>10</u>	<u>463,495</u>	<u>9</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附註十二、二二、二八及三一）	<u>56,175</u>	<u>1</u>	<u>190,921</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>234,619</u>	<u>5</u>	<u>675,630</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二三）	4,807	-	6,114	-
7050	財務成本（附註二四）	(24,614)	(1)	(33,958)	-
7020	其他利益及損失（附註二五）	(<u>547</u>)	<u>-</u>	<u>12,140</u>	<u>-</u>
7000	合 計	(<u>20,354</u>)	(<u>1</u>)	(<u>15,704</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨利	214,265	4	659,926	14
7950	所得稅費用（附註二六）	(<u>67,466</u>)	(<u>1</u>)	(<u>31,273</u>)	(<u>1</u>)
8200	本年度淨利	<u>146,799</u>	<u>3</u>	<u>628,653</u>	<u>13</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註十 八）	(\$ 2,908)	-	\$ 679	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8363	現金流量避險（附 註十九）	(951)	-	(542)	-
8300	本年度其他綜合損 益	(3,859)	-	137	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 142,940</u>	<u>3</u>	<u>\$ 628,790</u>	<u>13</u>
	每股盈餘（附註二七）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.56</u>		<u>\$ 2.65</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.56</u>		<u>\$ 2.60</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：關欣



經理人：關欣



會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司
權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 股 數 (仟 股)	本 金 額	資 本 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	餘 保 留 盈 餘 合 計	其 他 權 益 項 目 現 金 流 量 避 險	權 益 合 計
A1	103 年 1 月 1 日餘額	236,402	\$ 2,364,018	\$ 524,855	\$ 167,800	\$ -	\$ 1,059,024	\$ 1,226,824	(\$ 281)	\$ 4,115,416
	102 年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	28,888	-	(28,888)	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	281	(281)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(130,021)	(130,021)	-	(130,021)
	盈餘分配合計	-	-	-	28,888	281	(159,190)	(130,021)	-	(130,021)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	628,653	628,653	-	628,653
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	679	679	(542)	137
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	629,332	629,332	(542)	628,790
N1	員工執行認股權	1,719	17,189	18,058	-	-	-	-	-	35,247
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	4,811	-	-	-	-	-	4,811
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	238,121	2,381,207	547,724	196,688	281	1,529,166	1,726,135	(823)	4,654,243
	103 年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	62,865	-	(62,865)	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	542	(542)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(285,745)	(285,745)	-	(285,745)
	盈餘分配合計	-	-	-	62,865	542	(349,152)	(285,745)	-	(285,745)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	146,799	146,799	-	146,799
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,908)	(2,908)	(951)	(3,859)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	143,891	143,891	(951)	142,940
E1	現金增資	30,000	300,000	960,000	-	-	-	-	-	1,260,000
N1	員工執行認股權	755	7,554	9,518	-	-	-	-	-	17,072
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	63,371	-	-	-	-	-	63,371
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	268,876	\$ 2,688,761	\$ 1,580,613	\$ 259,553	\$ 823	\$ 1,323,905	\$ 1,584,281	(\$ 1,774)	\$ 5,851,881

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：關欣



經理人：關欣



會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司

現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$ 214,265	\$ 659,926
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,247,814	1,289,574
A20200	攤銷費用	36,329	26,877
A20300	呆帳費用（迴轉）提列數	(166)	522
A20900	財務成本	24,614	33,958
A21200	利息收入	(4,807)	(6,114)
A21900	員工認股權酬勞成本	63,371	4,811
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(550)	(236)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費損	-	15,222
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	24,411	86,067
A24100	外幣兌換淨益	(867)	(2,946)
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	(6,832)	5,192
A31150	應收帳款	(78,384)	(30,731)
A31160	應收關係人款項	432,851	(157,097)
A31190	其他應收關係人款項	(1,571)	141,190
A31200	存 貨	(26,158)	2,993
A31240	其他流動資產	(17,389)	5,213
A31250	其他金融資產	10,326	177
A32150	應付帳款	(9,440)	43,189
A32180	應付薪資及獎金	(39,994)	51,806
A32200	負債準備	22,960	9,515
A32230	存入保證金	-	(1,016,977)
A32230	應付費用及其他流動負債	(12,779)	26,426
A32240	淨確定福利負債	(655)	(1,716)
A32990	應付員工酬勞／紅利及董監酬勞	(65,222)	44,026
A33000	營運產生之現金	1,812,127	1,230,867
A33500	支付所得稅	(146,109)	(33,970)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,666,018</u>	<u>1,196,897</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 1,332,499)	(\$ 1,808,000)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	22,208	236
B03700	存出保證金增加	(3,157)	(3,564)
B03800	存出保證金減少	2,790	3,210
B04500	購置無形資產	(30,878)	(42,620)
B07500	收取之利息	<u>4,792</u>	<u>6,054</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>1,336,744</u>)	(<u>1,844,684</u>)
	籌資活動之現金流量：		
C01600	舉借長期借款	300,000	1,650,000
C01700	償還長期借款	(1,577,500)	(1,096,875)
C04500	發放現金股利	(285,745)	(130,021)
C04600	現金增資	1,260,000	-
C04800	員工行使認股權發行新股	17,072	35,247
C05600	支付之利息	(<u>25,160</u>)	(<u>35,261</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(<u>311,333</u>)	<u>423,090</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	17,941	(224,697)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>806,445</u>	<u>1,031,142</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 824,386</u>	<u>\$ 806,445</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：關欣



經理人：關欣



會計主管：林恕敏



附件五

精材科技股份有限公司
民國一〇四年度盈餘分派表

期初未分配盈餘	NT\$1,180,013,360
減：確定福利計劃之精算損失	(2,907,322)
調整後未分配盈餘	NT\$1,177,106,038
加：民國一〇四年度純益	146,798,504
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(14,679,850)
減：提列特別盈餘公積	(950,148)
截至民國一〇四年底可分配保留盈餘	NT\$1,308,274,544
分派項目：	
減：普通股現金股利（每股新台幣0.5元）	(134,438,065)
期末未分配盈餘	NT\$1,173,836,479

董事長：關欣



經理人：關欣



會計主管：林恕敏



附件六

董事（含獨立董事）候選人名單

職稱	姓名	持有股數	學歷/經歷	現任職務
董事	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：關欣	92,778,303 股	<u>學歷</u> 清華大學材料科學與工程研究所碩士 國立成功大學材料科學與工程系學士 <u>經歷</u> 台積公司特殊計劃處長/後段技術暨服務處處長/產品工程處處長 Systems on Silicon Manufacturing Co. 營運副總經理	● 本公司董事長暨總經理 ● 采鈺科技(股)公司董事長暨執行長 ● 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 董事
董事	台灣積體電路製造股份有限公司 代表人：林錦坤	92,778,303 股	<u>學歷</u> 國立彰化師範大學工業教育系學士 <u>經歷</u> 台積公司成熟技術事業總廠長、十二廠廠長、六廠廠長及三廠廠長	● 台積公司營運/六吋及八吋廠暨製造技術中心副總經理 ● 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 董事 ● 采鈺科技股份有限公司董事
獨立董事	王文宇	0 股	<u>學歷</u> 美國史丹福大學法學博士 <u>經歷</u> 本公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 創意電子公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 凱基銀行獨立董事及薪資報酬委員會委員 統一超商公司獨立	● 創意電子公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 ● 凱基銀行獨立董事及薪資報酬委員會委員 ● 統一超商公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 ● 國立臺灣大學法律學院教授 ● 國際比較法學會 (IACL) 台灣分會召集人

職稱	姓名	持有股數	學歷/經歷	現任職務
			立董事及薪資報酬委員會召集人 國立臺灣大學法律學院教授 國際比較法學會 (IACL) 台灣分會召集人	
獨立董事	謝徽榮	0 股	<u>學歷</u> 國立臺灣大學商研所碩士 國立清華大學核子工程系學士 <u>經歷</u> 世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理 美商美國銀行副總經理	● 茂達電子股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會主席 ● 寶勝國際(控股)有限公司獨立董事及薪酬委員會主席 ● 茂迪公司薪資報酬委員會委員
獨立董事	溫瓊岸	0 股	<u>學歷</u> 國立成功大學電機工程學系博士、碩士及學士 <u>經歷</u> 國立交通大學策略辦公室執行長、電子工程學系副教授	● 南茂科技股份有限公司獨立董事 ● 國立交通大學電子工程學系教授、策略辦公室執行長及研究發展處副研發長

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制內容

職稱	姓名	經營業務或現任職務
董事	台灣積體電路製造股份有限公司	● 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置。 ● 提供前述產品之封裝與測試服務。 ● 提供積體電路之電腦輔助設計技術服務。 ● 提供製造光罩及其設計服務。 ● (CC01080 電子零組件製造業)
	代表人：關欣	● 采鈺科技(股)公司董事長暨執行長 ● 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 董事
	代表人：林錦坤	● 台積公司營運/六吋及八吋廠暨製造技術中心副總經理 ● 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 董事 ● 采鈺科技股份有限公司董事
獨立董事	王文字	● 創意電子公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 ● 凱基銀行獨立董事及薪資報酬委員會委員 ● 統一超商公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人 ● 國立臺灣大學法律學院教授 ● 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人
獨立董事	謝徽榮	● 茂達電子股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會主席 ● 寶勝國際(控股)有限公司獨立董事及薪酬委員會主席 ● 茂迪公司薪資報酬委員會委員
獨立董事	溫瓊岸	● 南茂科技股份有限公司獨立董事 ● 國立交通大學電子工程學系教授、策略辦公室執行長及研究發展處副研發長